

優れた印刷性で、ボイドの少ないバンプを形成

Forms bumps with few voids, due to excellent printability

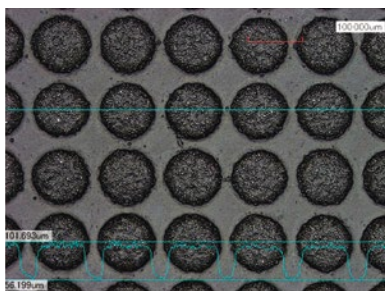
特長

- 優れたペースト設計が、加熱ダレによるブリッジやはんだボールを抑制
- 優れた熔融特性が、ボイドの少ないバンプを形成
- 優れた粘弾特性が、微小で均一なバンプを形成

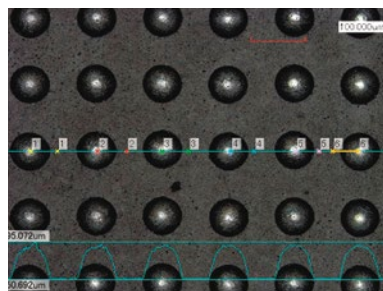


仕様

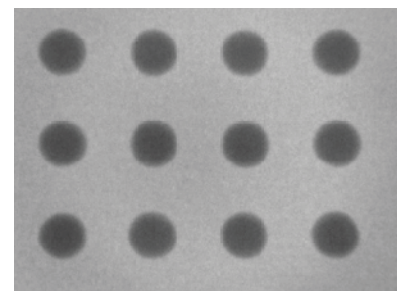
- 120 μ m Pitch の印刷によるバンプの形成



印刷後

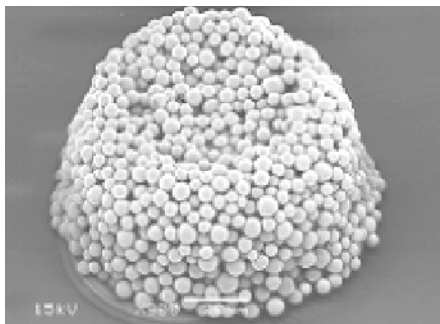


リフロー後 バンプ形成

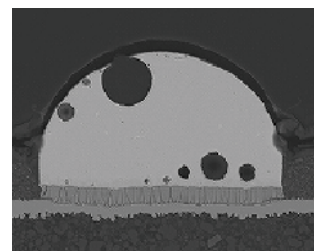


X線検査/ボイド激減

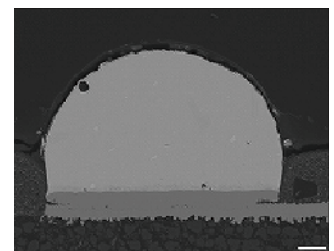
- 微小はんだ粉により良好な微細バンプを印刷形成



- BPSでボイドを激減

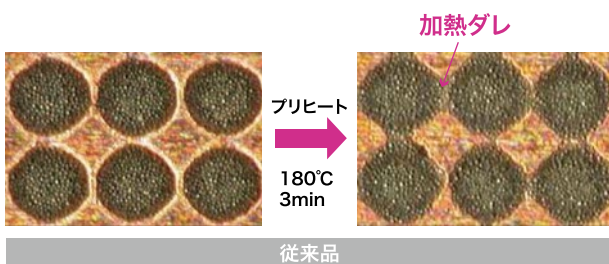


従来品

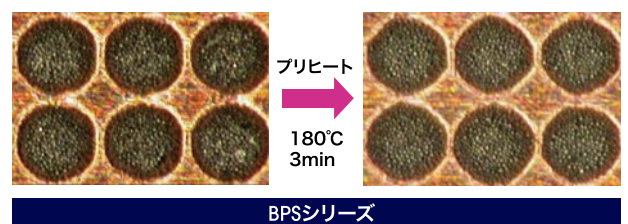


BPSシリーズ

- プリヒート後の加熱ダレを防止、信頼性の高いバンプを形成



従来品



BPSシリーズ